

東京エレクトロン

2008年3月期第1四半期 決算説明会

2007年7月27日

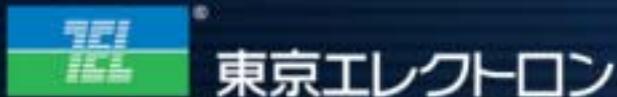
資料取扱い上の注意

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は円単位で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2008年3月期第1四半期 決算概要

経理部長 佐伯幸雄

2007年7月27日

2008年3月期 第1四半期決算(連結)

当第1四半期の業績

(単位: 億円)

	2007年3月期				2008年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	対前年増減
売上高	1,792	2,113	2,100	2,513	2,124	18.6%
SPE	1,259	1,579	1,588	1,998	1,657	31.7%
FPD	289	236	260	221	214	26.0%
EC/CN	240	294	249	289	251	4.7%
その他	2	2	2	2	1	54.9%
売上総利益	544 (30.4%)	649 (30.7%)	739 (35.2%)	793 (31.6%)	765 (36.0%)	40.7%
販管費	285	325	310	364	335	17.4%
営業利益	258 (14.4%)	323 (15.3%)	429 (20.4%)	428 (17.0%)	430 (20.3%)	66.4%
経常利益	267	314	421	436	411	54.0%
税前利益	273	311	421	437	424	55.5%
当期純利益	162	209	269	270	261	60.9%
研究開発費	126	145	133	164	148	17.5%
設備投資額	47	49	93	81	70	48.9%
減価償却実施額	42	45	48	51	46	8.9%

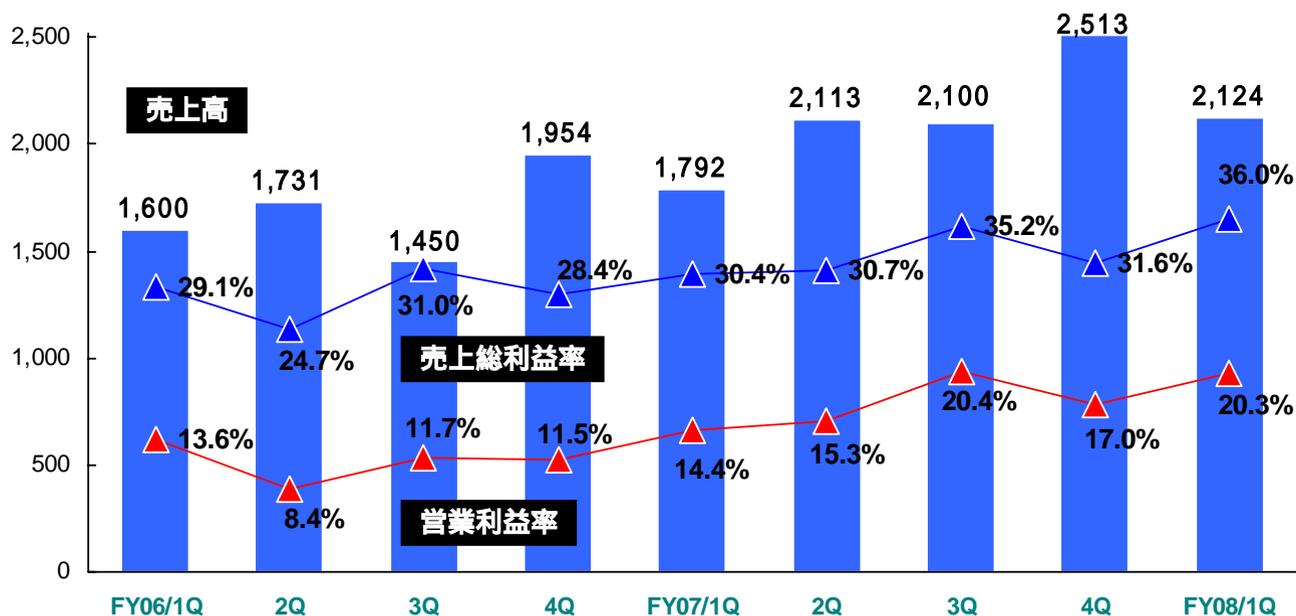
SPE: 半導体製造装置, FPD: FPD製造装置, EC: 電子部品, CN: コンピュータ・ネットワーク



2008年3月期 第1四半期決算(連結)

売上・利益率推移

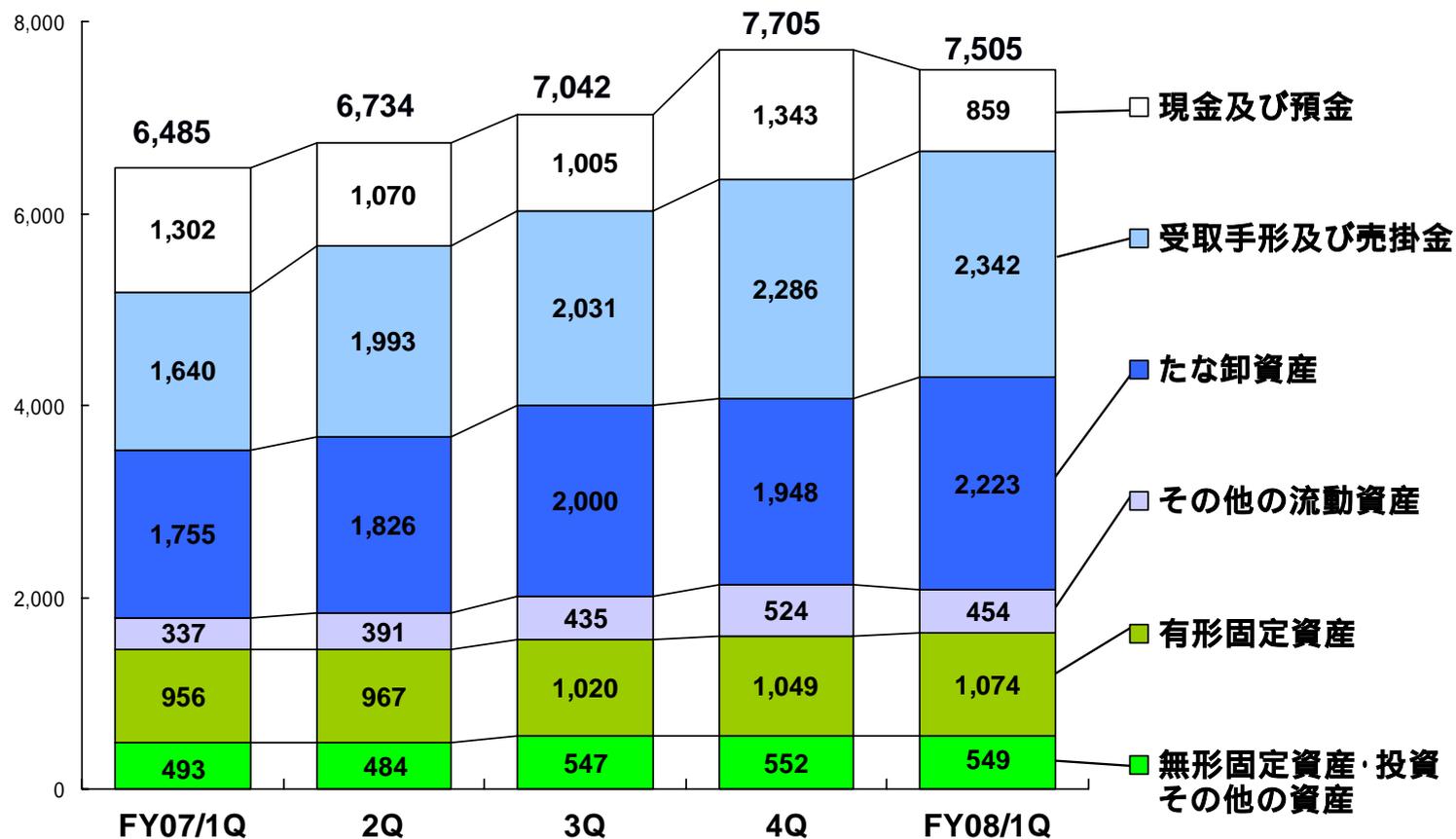
(単位: 億円)



2008年3月期 第1四半期決算(連結)

資産

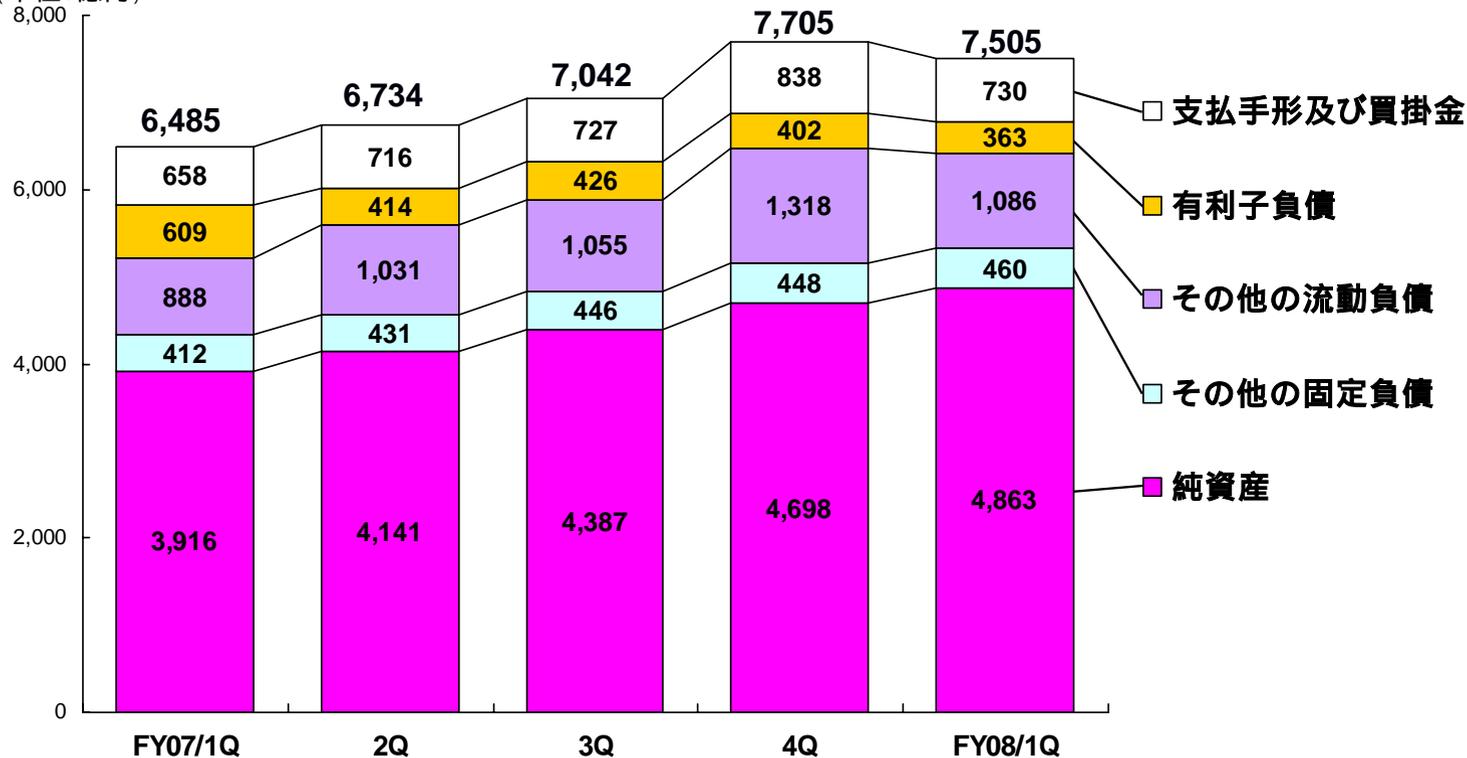
(単位:億円)



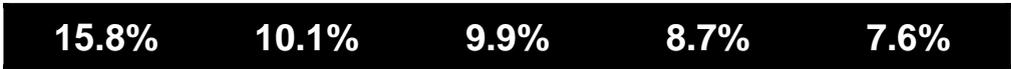
2008年3月期 第1四半期決算(連結)

負債・純資産

(単位:億円)
8,000



有利子負債/自己資本

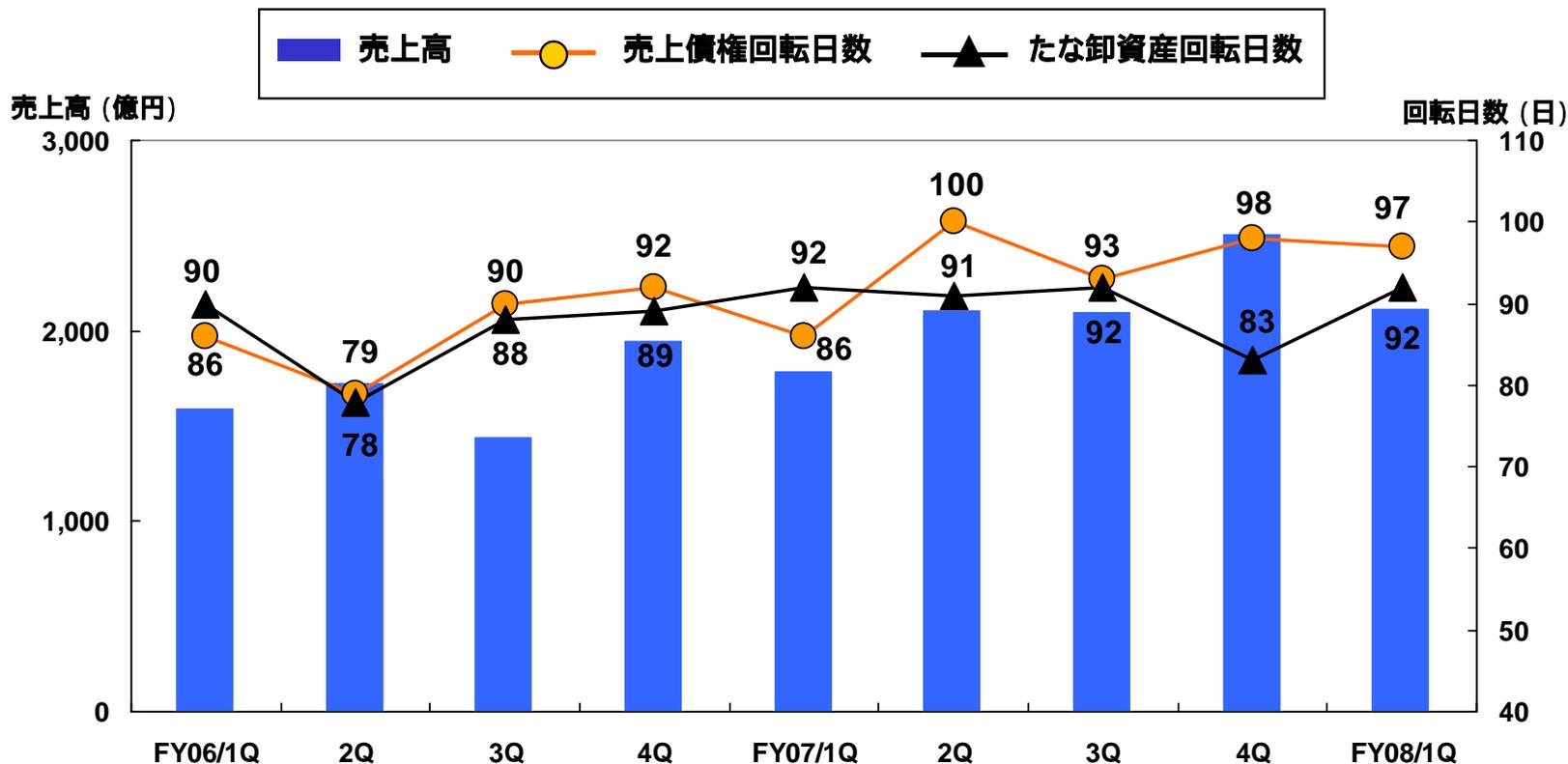


* 自己資本 = 純資産 - (新株予約権+少数株主持分)



2008年3月期 第1四半期決算(連結)

たな卸資産・売上債権の回転日数



- 回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365
- FY2006/1Qの回転日数算出に使用したFY2005/2Q売上高 = 新会計方針によるFY2005/1Hの売上高 ÷ 2



2008年3月期 第1四半期決算(連結)

キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	2007年3月期					2008年 3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	合計	1Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	38	6	133	364	542	295
投資活動によるキャッシュ・フロー	42	351	146	5	252	46
財務活動によるキャッシュ・フロー	93	186	46	19	347	142

現金及び現金同等物の増加額	97	531	235	338	56	484
---------------	----	-----	-----	-----	----	-----

現金及び現金同等物の期末残高	1,302	770	1,005	1,343		859
----------------	-------	-----	-------	-------	--	-----



2008年3月期 第1四半期決算(連結)

事業の種類別セグメント情報

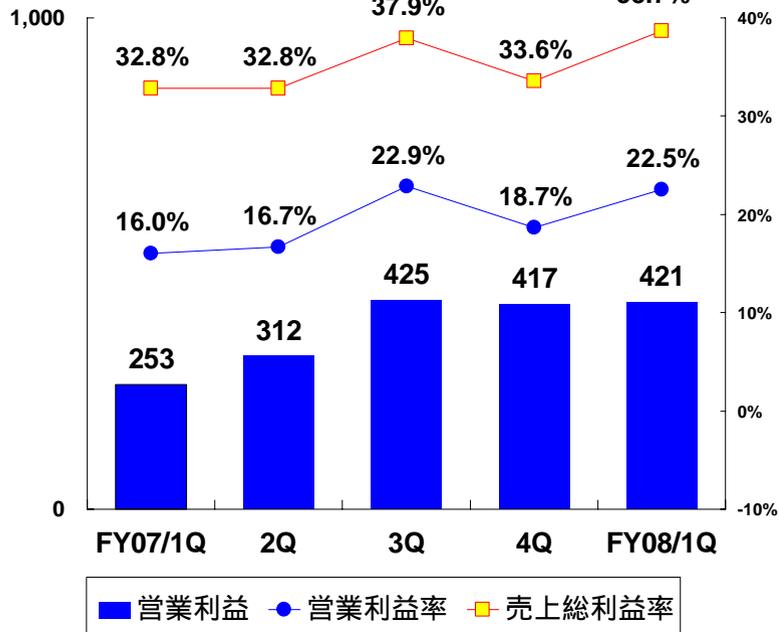
産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、その他)

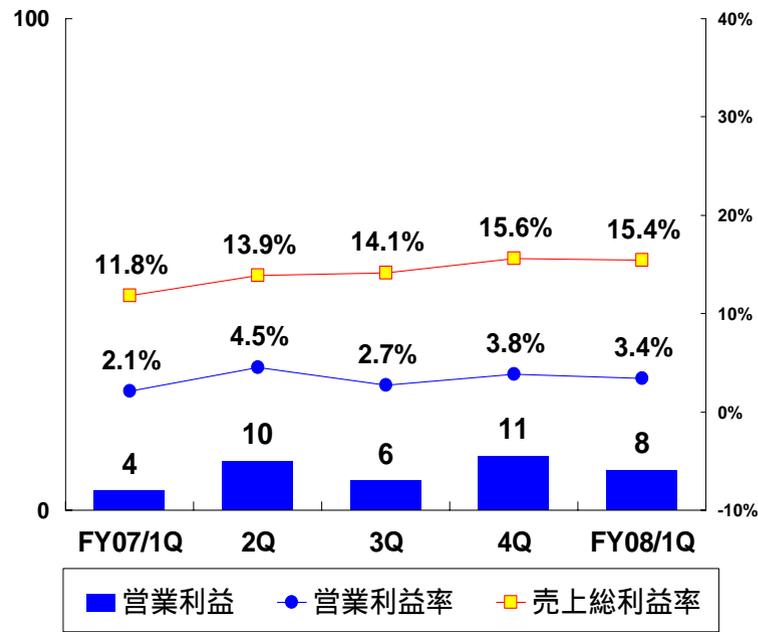
電子部品・情報通信機器

(電子部品、コンピュータ・ネットワーク)

(単位:億円)



(単位:億円)



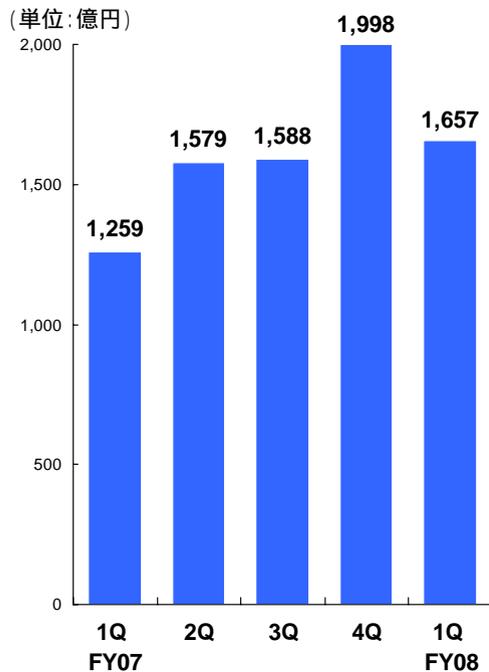
- セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。
- 2007年3月期の第2Q以前はセグメント区分の組み替えを行っていません。



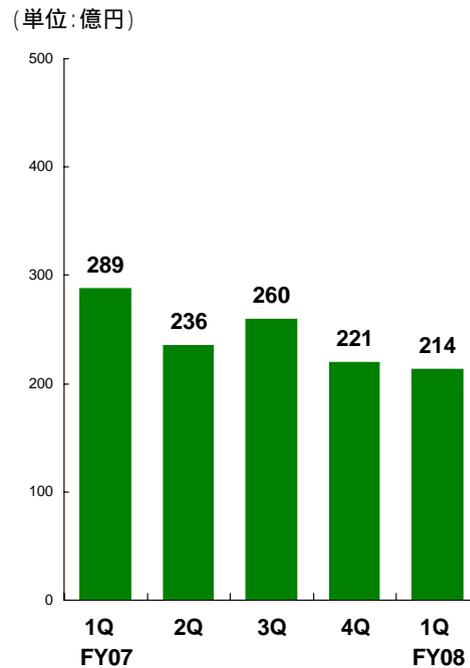
2008年3月期 第1四半期決算(連結)

部門別売上高

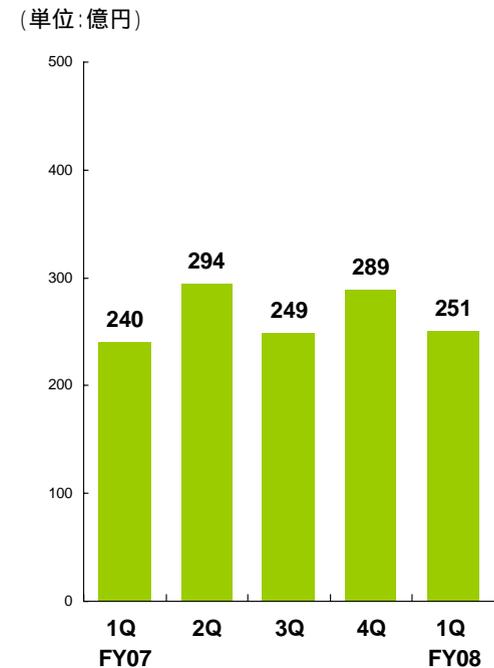
SPE部門 (半導体製造装置)



FPD部門 (フラットパネルディスプレイ製造装置)



EC/CN部門 (電子部品/コンピュータ・ネットワーク)



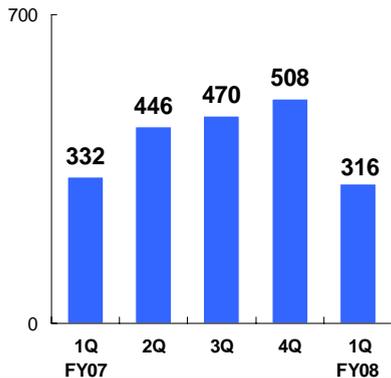
上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります(当1Q売上高1億円)。



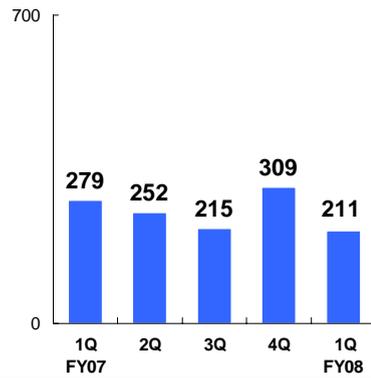
2008年3月期 第1四半期決算(連結) S P E 部門地域別売上高

(単位:億円)

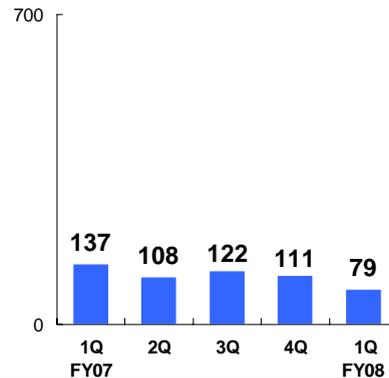
日本



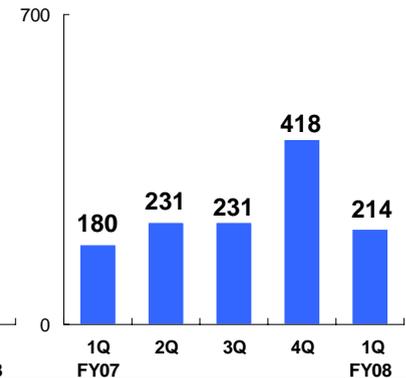
米国



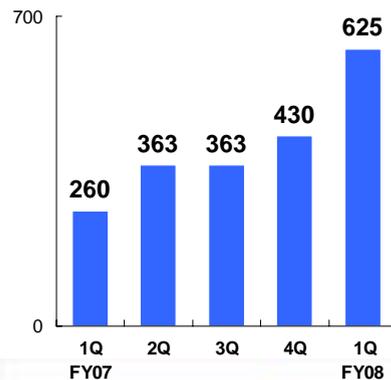
欧州



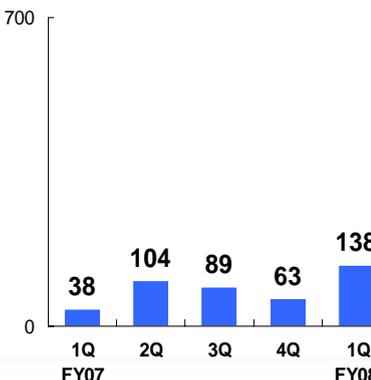
韓国



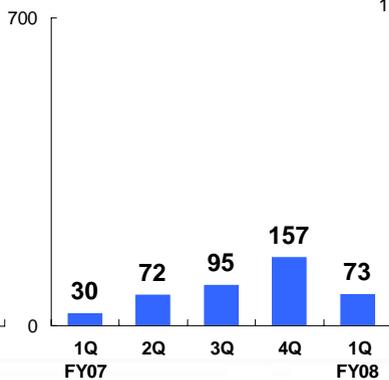
台湾



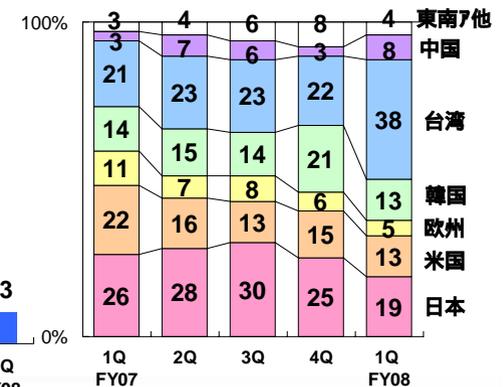
中国



東南アジア他



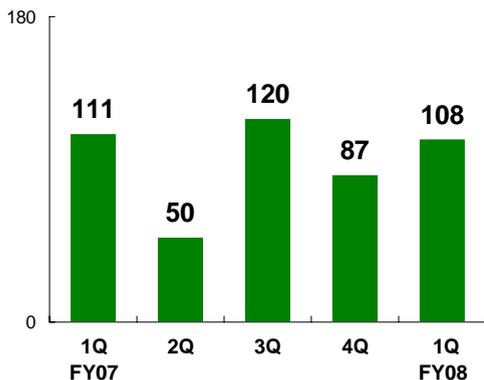
地域別構成比



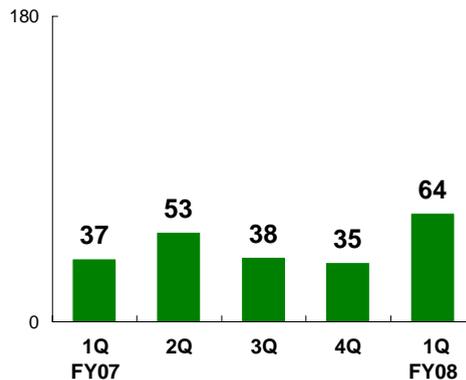
2008年3月期 第1四半期決算(連結) FPD部門地域別売上高

(単位:億円)

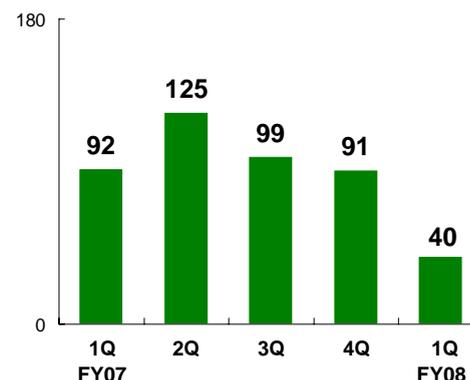
日本



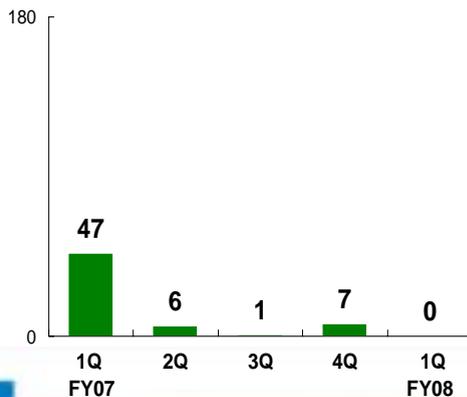
韓国



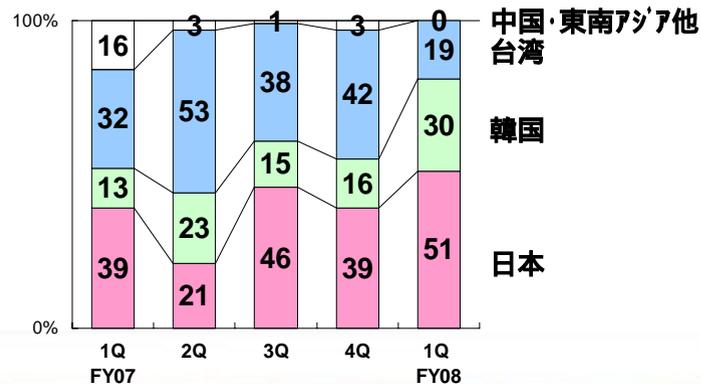
台湾



中国・東南アジア他



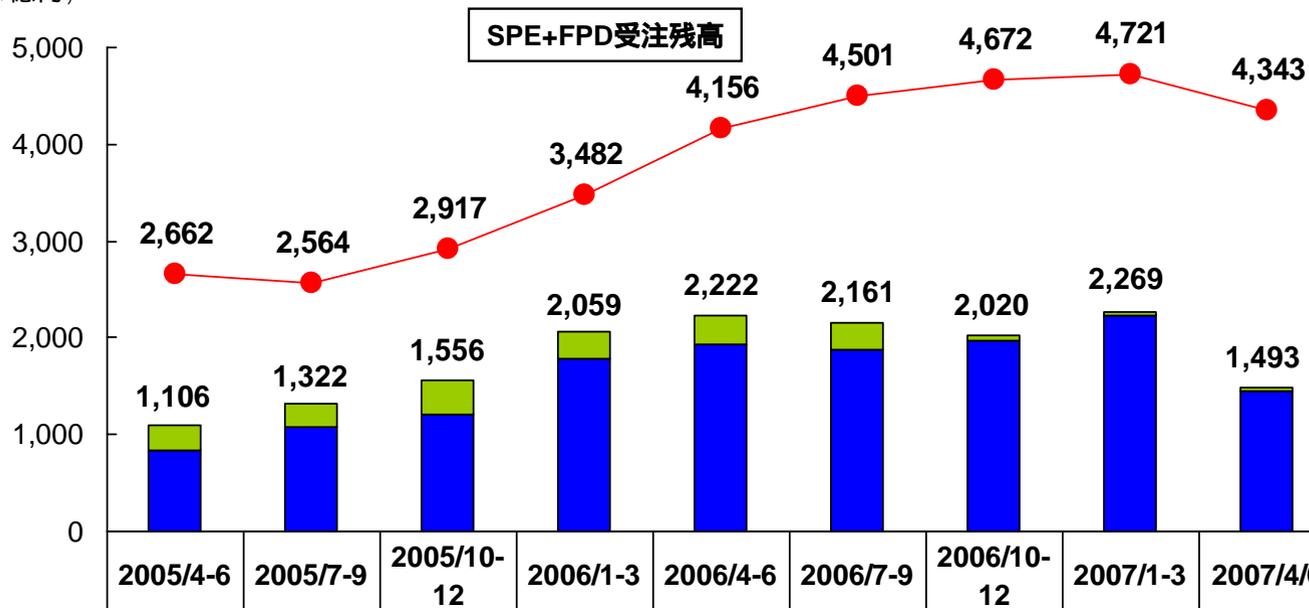
地域別構成比



2008年3月期 第1四半期決算(連結)

SPE+FPD受注額, 受注残高

(単位: 億円)



FPD製造装置 受注額	276	240	344	277	296	275	55	42	41
半導体製造装置 受注額	829	1,081	1,211	1,782	1,926	1,886	1,964	2,227	1,452
受注残高	2,662	2,564	2,917	3,482	4,156	4,501	4,672	4,721	4,343

受注残高内訳

FPD	698	748	927	990	997	1,036	831	652	479
SPE	1,963	1,816	1,990	2,491	3,158	3,464	3,841	4,069	3,864

● 2006年1-3月期より、受注額・受注残高ともに連結ベースに表示変更しています。

